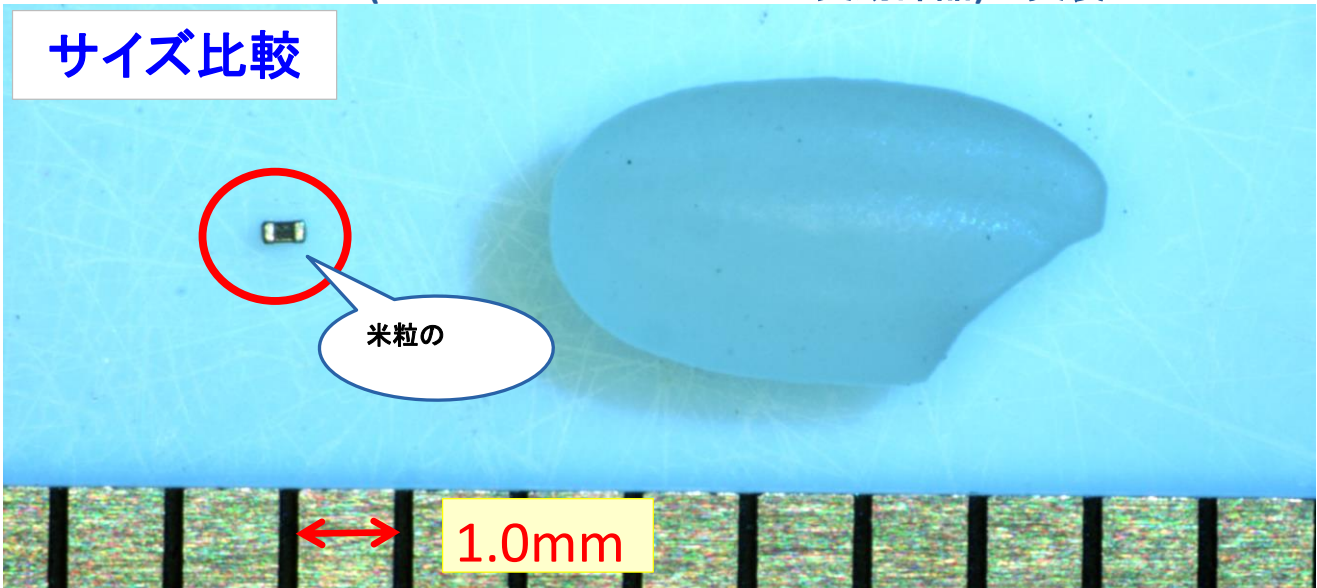
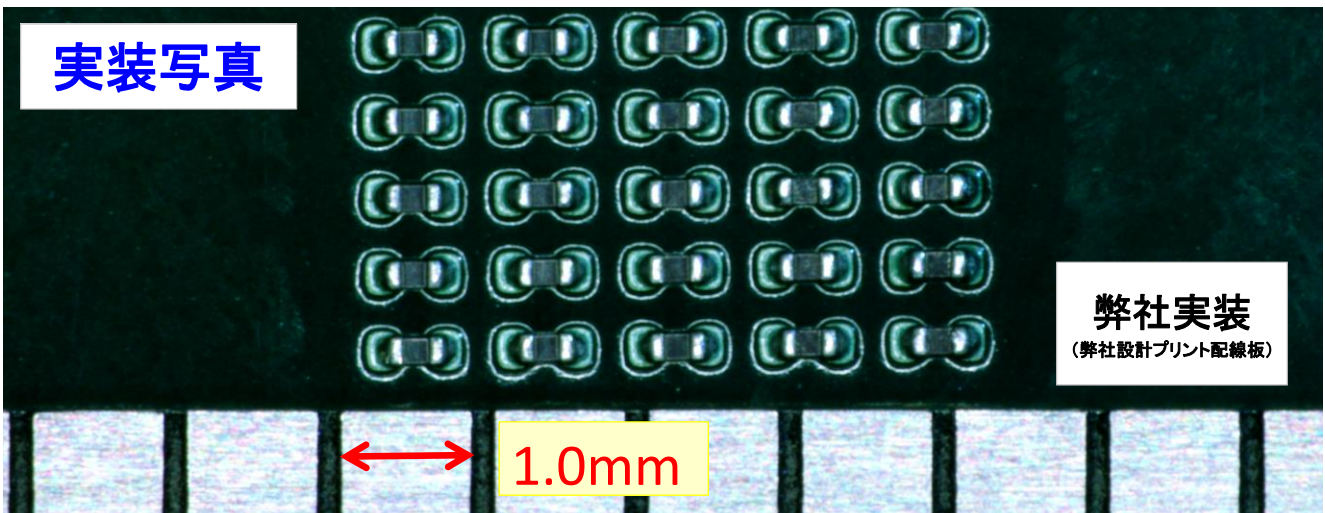


0402型 SMD (L0.4mm × W0.2mmサイズ受動部品)の実装

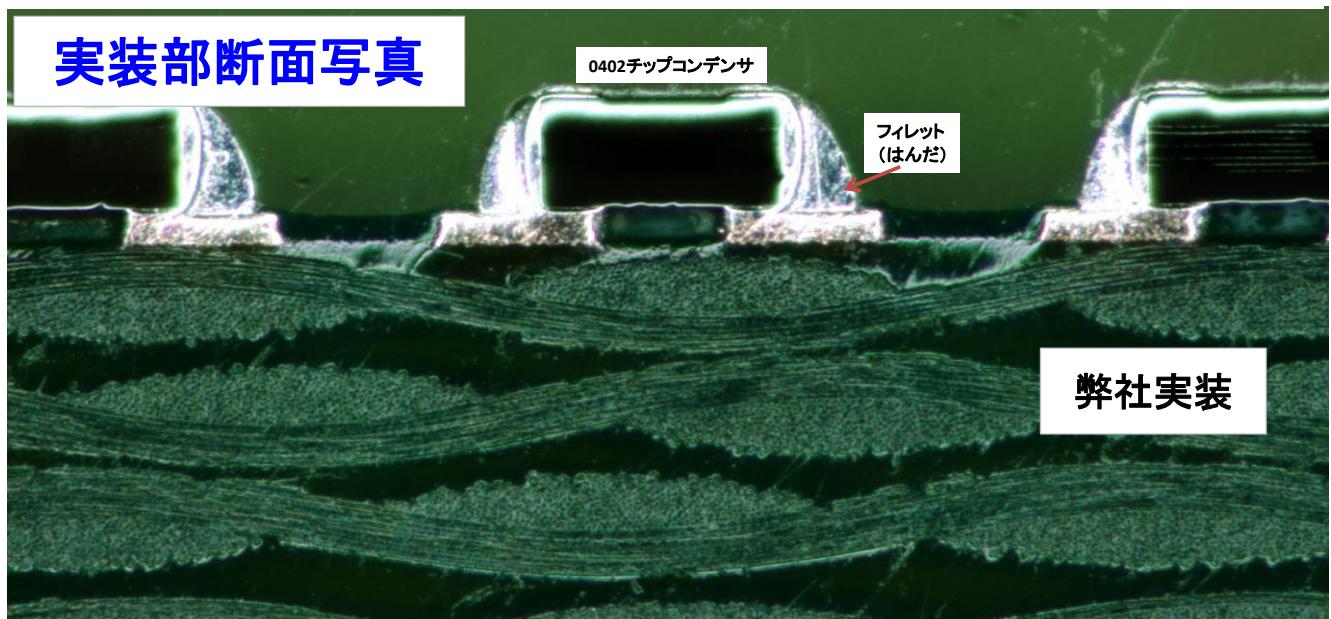
サイズ比較



実装写真



実装部断面写真



■PoP (Package on Package) の実装

・On-board stack方式

基板にはんだを印刷後、親亀BGA ICを実装。
子亀BGA ICにはんだ(フラックス)を転写し、親亀上を実装。

